混練におけるフィラー微細化の 数値シミュレーション

○ 辰巳 怜 (東大環安セ)

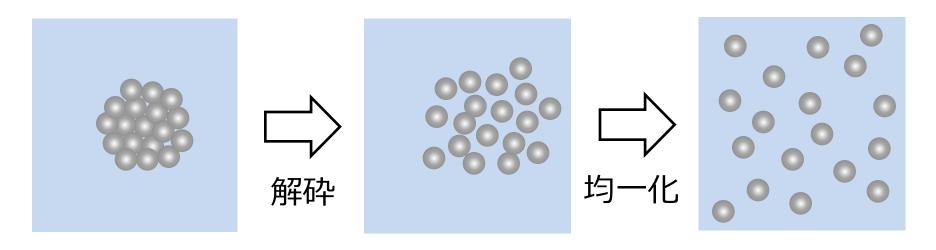
小池 修 (PIA)

山口由岐夫 (PIA)

辻 佳子 (東大環安セ/東大院工)

ポリマーコンポジットの混練

溶融ポリマー中でのフィラー混合



・界面エネルギーの低減: 分散剤,表面改質剤

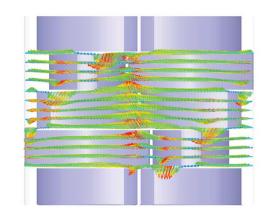
・機械的エネルギーの投入: 流動場

混練の課題 解砕不良,不均一化,熱劣化 CAE(Computer Aided Engineering)による課題解決

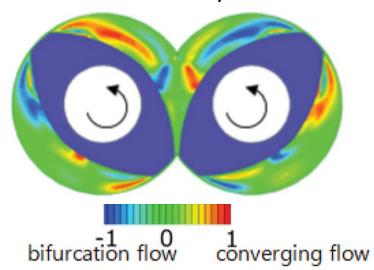
混練におけるCAE

装置内流動解析(装置スケール)

装置形状,操作条件 → 流動状態(剪断率,流動様式)



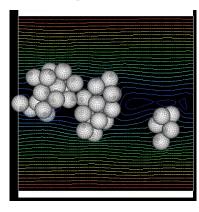
Nakayama et al., AIChE J. (2018).



・フィラー混合過程の解析(フィラースケール)

流動状態 (剪断率,流動様式)

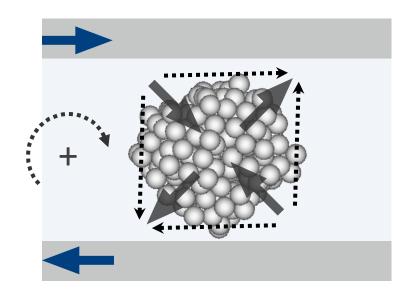
→ 混練性能 (解砕,均一化)



目的

- ・解砕特性の解析: 分散度 vs. 剪断率
 - ← 直接数値シミュレーション (SNAP)

・単純剪断流れにおける凝集体解砕



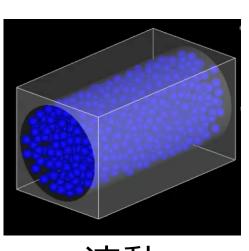
直接数値シミュレーション

Direct Numerical Simulation

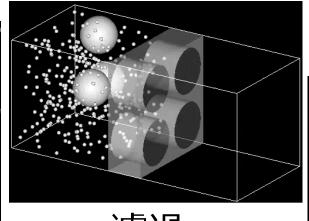
粒子:運動方程式

流体力 ↑ 境界条件 ← 連成: Immersed Boundary 法

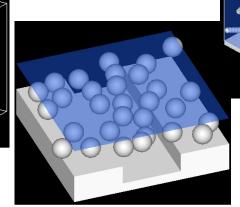
流動場: Navier-Stokes方程式



流動



濾過



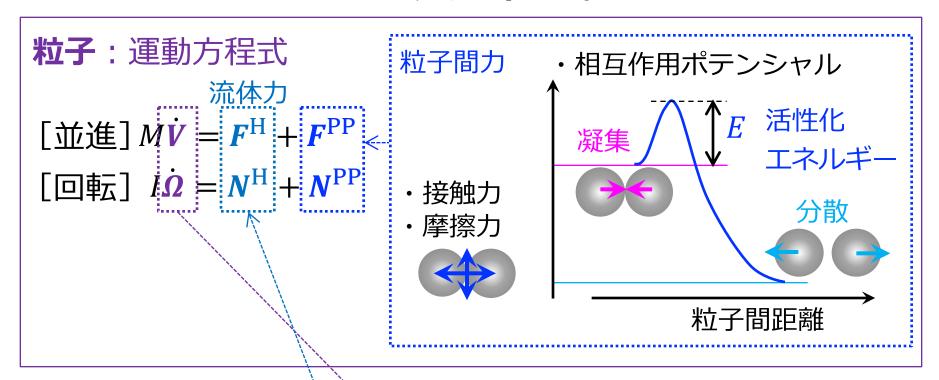
乾燥

SNAP研究会



Structure of NAno Particles 粒子分散系プロセスの課題解決

基礎方程式

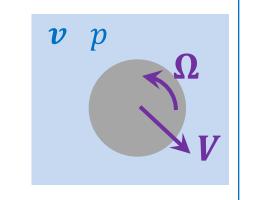


流動場: Navier-Stokes方程式

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla \boldsymbol{v}\right) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{f}_{P}$$
 粒子速度 境界条件の強制

$$\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0$$

応力:
$$\boldsymbol{\sigma} = -p\boldsymbol{I} + \eta[\nabla \boldsymbol{v} + (\nabla \boldsymbol{v})^{\top}]$$

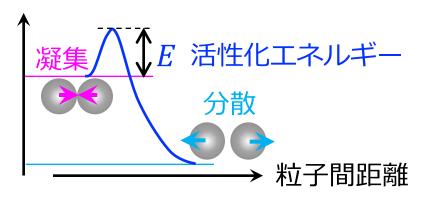


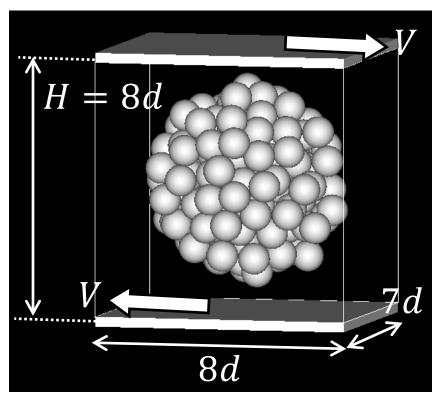
計算条件

単純剪断流れにおける凝集体解砕

- ・凝集体径 6d 一次粒子径 d体積分率 0.18
- ·剪断率 $\dot{\gamma} = 2V/H$
- ・無次元剪断率

$$\Gamma = \frac{\eta \dot{\gamma} d^3}{E} = \frac{$$
剪断エネルギー
活性化エネルギー





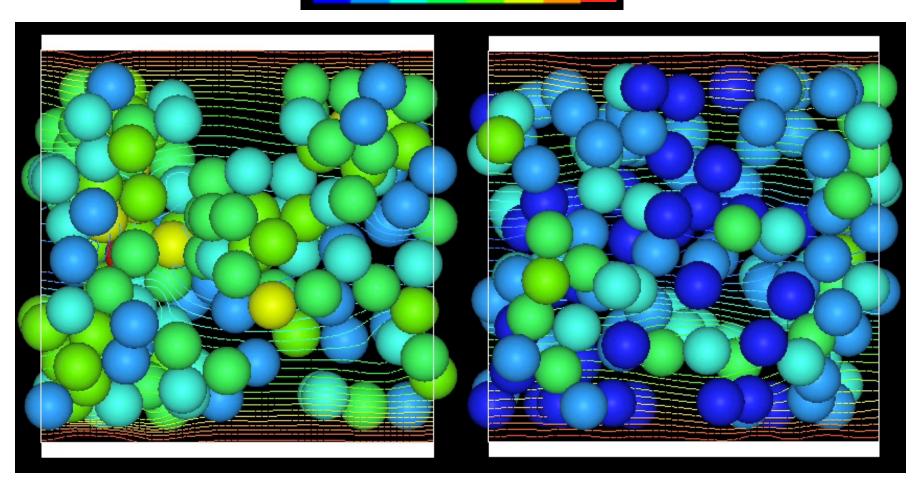
周期境界条件: x, y

$$y \xrightarrow{Z} x$$

→ 解砕特性:分散度 vs. 剪断率

計算結果

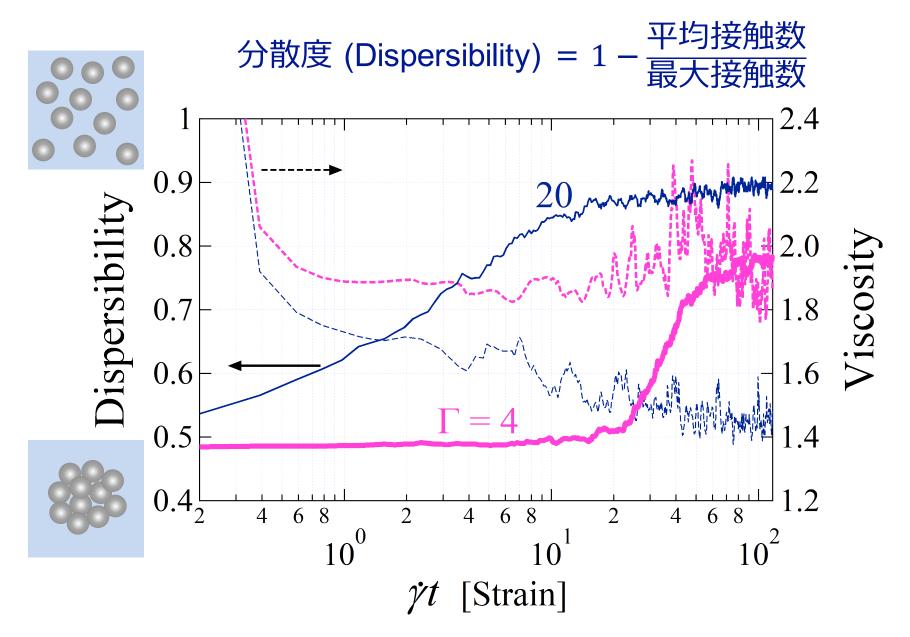
0 接触数 6



$$\Gamma = 4$$

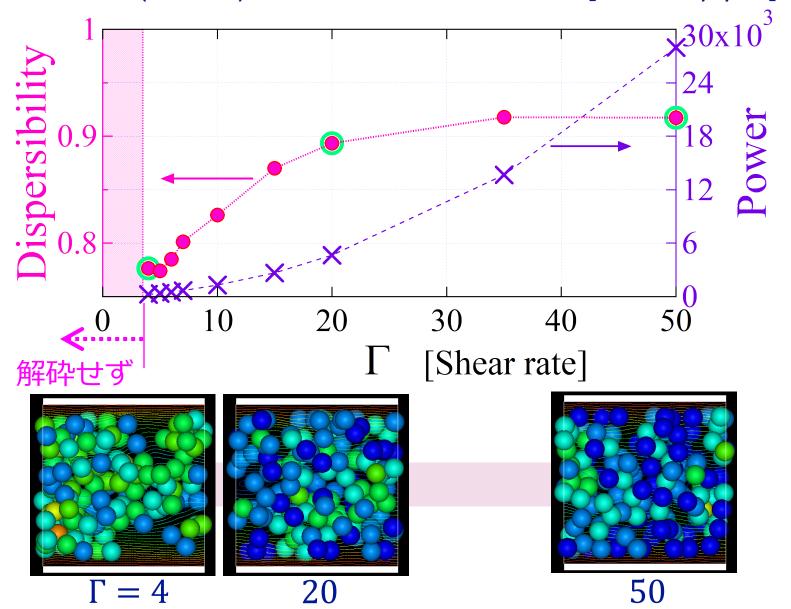
$$\Gamma = 20$$

解砕の進展



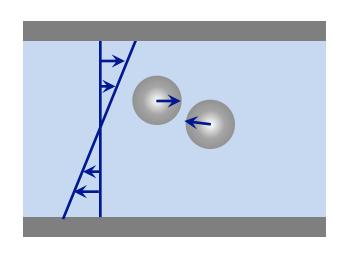
分散度 vs. 剪断率

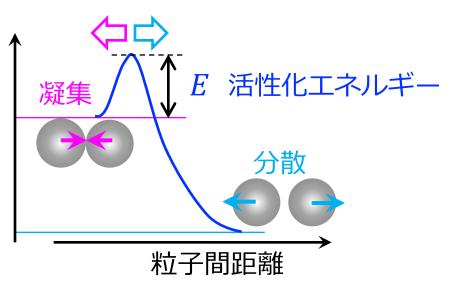
仕事率 (Power) =壁面応力×壁面速度 [unit: $E^2/\eta d^3$]



流動場中の分散・凝集

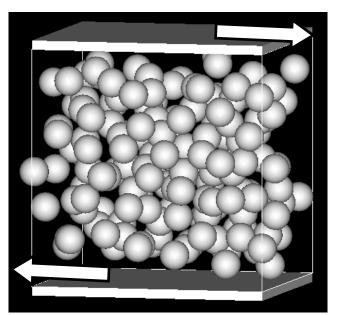
流動場による粒子の接近 → 剪断エネルギー vs. 粒子間ポテンシャル





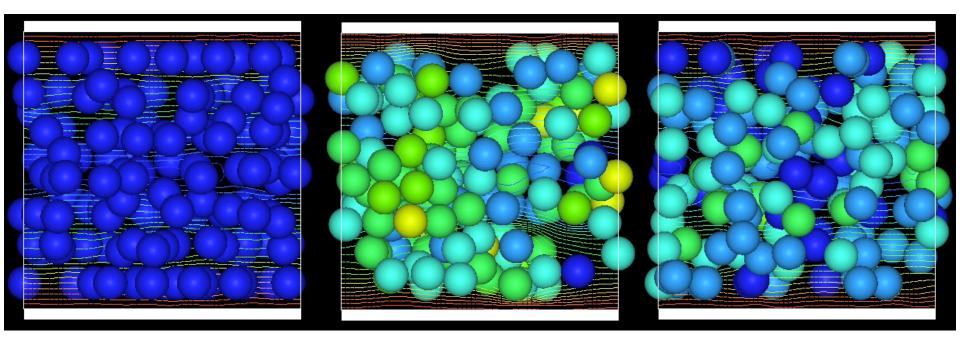
剪断流れにおける分散性の解析

→ 分散状態が維持される剪断率



計算結果

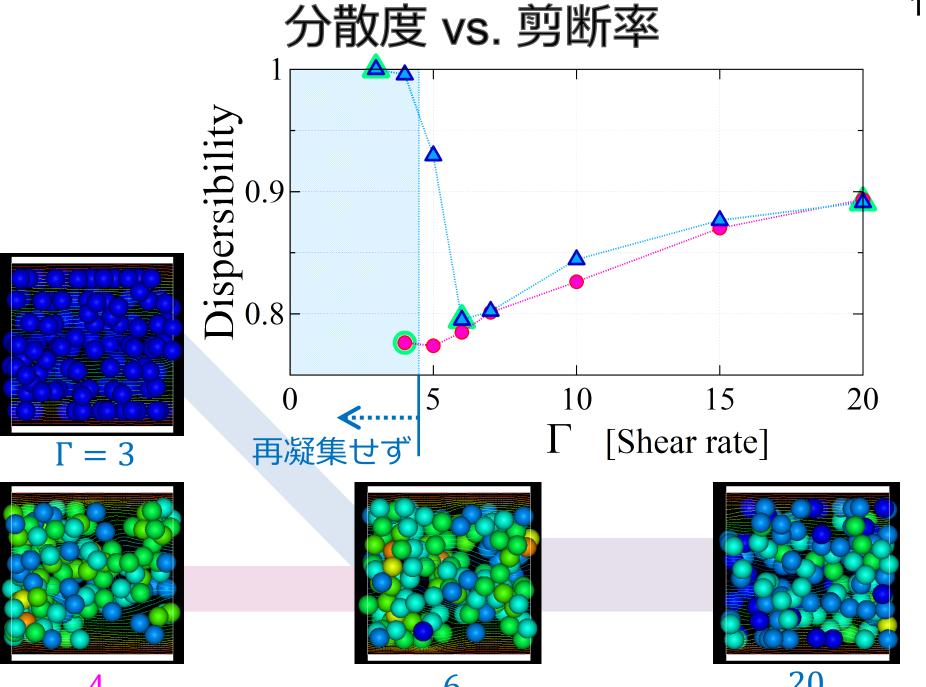
0 接触数 6



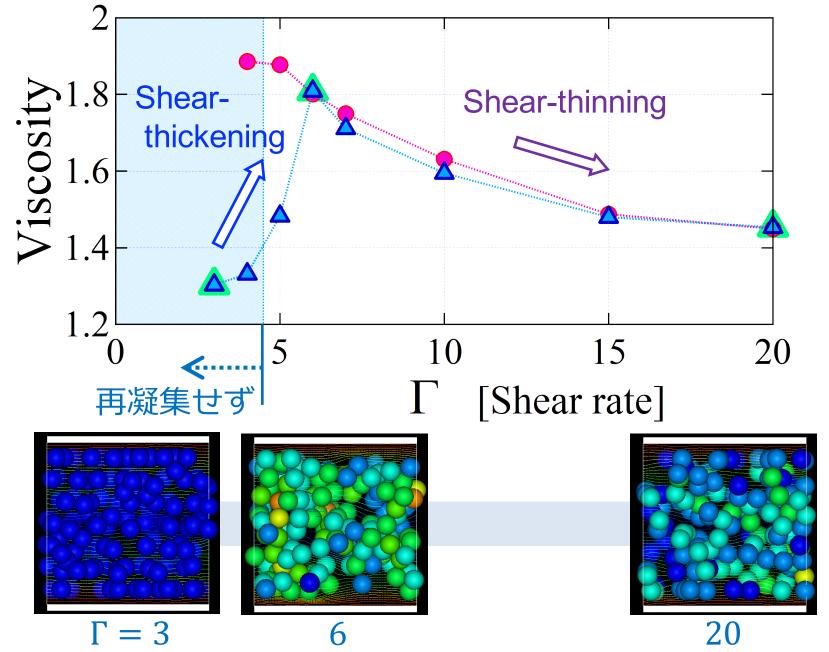
$$\Gamma = 3$$

$$\Gamma = 6$$

$$\Gamma = 20$$



粘度 vs. 剪断率



総括

- ・数値シミュレーションSNAPによる解砕特性の解析: 分散度 vs. 剪断率
- ・高剪断率の注意点:分散度の上限(解砕効率低下),発熱(品質劣化)
- ・再凝集が起こる剪断率領域に注意
 - ← shear-thickeningの把握